

10月31日(木) 14:00-16:40

セッションチェアマン： 森川 泰宏(株アルバック)・藤原 健典(東レ株)

◆ 先端パッケージの技術動向(仮題)



株式会社 SBR テクノロジー
代表取締役
西尾 俊彦

[講演要旨]

[講演者プロフィール]

1988年 日本アイ・ビー・エム(株)に入社。世界初となったビルドアップ基板へフリップチップ実現の開発に従事。そのテクノロジーをウェアラブル PC などモバイル製品への適用をリードし、IBM Distinguished Engineer (技術理事)となる。

2011年より STATChipPAC Ltd. にて FO-WLP のプロモーションを行い、日本法人の社長を務める。
2015年より半導体パッケージのコンサルティングサービスを起業し、株式会社 SBR テクノロジーの代表取締役兼コンサルタントとして活動中。

◆ CMOS イメージセンサにおける 3D 積層技術の現状と展望(仮題)



ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
第2研究部門
部門長
岩元 勇人

[講演要旨]

[講演者プロフィール]

◆ Process Challenges for High Bandwidth Memory(HBM)



マイクロンメモリジャパン株式会社
Technology Development
Process Development
Sr Manager-BEOL
横井 直樹

[講演要旨]

High bandwidth memory (HBM) is a 3D-stacked, high performance memory device used as a part of system in package (SiP) and its market is rapidly expanding. In this presentation, the configuration of a SiP utilizing HBM cubes is shown. Also, the challenges in silicon process to enable HBM cubes and the electric characteristics of a TSV are discussed. In addition, the interaction between silicon process and packaging to build cubes is overviewed.

[講演者プロフィール]

1995年3月、大阪大学大学院後期課程修了。三菱電機株式会社に入社。ルネサステクノロジ株式会社、エルピーダメモリ株式会社を経て、2013年よりマイクロンメモリジャパン株式会社に所属。エルピーダメモリ在職中の2011年よりVia Last方式のTSV及び関連するプロセスの技術開発に従事し、マイクロンではVia Middle方式でのTSVのプロセス技術開発に従事する。これらの技術開発を通して、HBMを始めとする積層DRAMの製品化に携わる。2022年より現職。

※本講演に興味を持たれた方は、こちらの講演もご覧になっています。

【E-2】光通信デバイス

【E-3】高密度実装